



【TSIA 新聞稿 2023.10.27】

10月27日2023 TSIA年會圓滿成功

Keynote 微軟公司(Microsoft)兩位嘉賓精彩互動【AI專題】

《生成式人工智慧與半導體》討論熱烈

會中並同時頒發2023 TSIA半導體獎

產學研半導體菁英齊聚新竹矽谷!

台灣半導體產業協會(TSIA)於10月27日舉辦2023TSIA年會【EMPOWER AI with SEMICONDUCTOR】，由理事長台積電侯永清資深副總開幕致詞，特邀微軟公司(Microsoft)兩位重量級嘉賓Corporate Vice President Rani Borkar 及Eric Boyd擔任Keynote演講貴賓，分享《AI》專題，並舉行由常務理事聯發科技子公司聯發聯發創新基地總負責人許大山博士主持論壇主持的《生成式人工智慧與半導體》主題論壇。

理事長於致詞中表示，這幾年由於中美貿易衝突、以及地緣衝突(烏俄戰爭、兩岸緊張、以巴衝突等)持續不斷地影響全球產業發展，全球半導體產業供應鏈也面臨嚴重衝擊，挑戰比之前更加嚴峻。然而去年台灣半導體產業在此產業鏈中依舊締造了「製造第一、封裝測試第一、IC設計第二」的亮麗成績。依據台灣半導體產業協會(TSIA)統計，2022年台灣半導體產業總產值已突破新臺幣4.8兆元(USD\$162.3B)，較2021年成長18.5%。但因為全球經濟惡化及消費需求疲弱，預估2023年台灣IC產業產值將下探新臺幣4.25兆元(\$142.6B) 較2022下挫-12.1%，在此謹代表TSIA 仍感謝台灣半導體產業各公司的辛勞及努力，未來讓我們再一起共創台灣半導體產業另一高峰。

TSIA致力於人才培育及推廣多年，本會2023年TSIA半導體獎已於3月中揭曉將稍後頒獎。具博士學位之新進研究人員由國立台灣大學電子工程學研究所博後研究員吳易忠獲獎，他也是2018年TSIA半導體獎博士生得主，是10年來TSIA半導體獎第2位雙料得主；今年博士研究生獎分別由5校11位同學獲獎。博士研究生獎有兩位女性得主，分別由國立陽明交通大學電子研究所黃欣慧同學及國立中山大學材料與光電科學學系吳珮瑜同學獲獎，很高興見到女性在半導體領域的傑出表現。在此，鼓勵年輕精英人才能進入前瞻半導體領域，一起為台灣半導體產業的前景共同努力、再創產業高峰!

面對國際2050淨零排放的挑戰及綠色供應鏈的需求，低碳轉型已成為企業永續經營的新賽局，為符合如此複雜且困難的淨零減碳要求，TSIA會員公司都將減碳納入經營策略目標中，擬定短中長期行動方針，藉由自主減量，採用再生能源，進行低碳/負碳交易等積極行動逐步達成減碳目標。為達成淨零目標除企業努力外更需要政府基礎建設與相關法規政策的支持，協會會員也積極與政府溝通，期望產官共同合作，達到永續發展的目標。

在國際合作方面，世界半導體理事會的CEO年會在歷經了3年以視訊方式舉辦後，今年終於得以以實體方式於韓國首爾華克山莊舉行，我要在此特別感謝5月25日撥冗與我一同出席首爾WSC會議的代表，包括TSIA常務理事-鈺創盧超群董事長、TSIA監事長-漢民陳溪新總經理、力積電朱憲國執行副總、以及工研院吳志毅副總(現為TSIA執行長)，謝謝各位對TSIA參與WSC事務的積極支持，提升台灣代表團的實力。同時，我也要感謝本會JSTC委員會在WSC各項議題上投入的心力，我也期許JSTC委員會持續積極參與WSC各項議題的討論，爭取並捍衛台灣半導體廠商的權益。

就外在環境方面，除了美中貿易衝突，以及兩岸緊張情勢，對所有行業都帶來更嚴峻的挑戰，包括半導體產業。而中國政府近年來對其國內半導體產業的推動從未停歇，包括在半導體設計、製造、封裝產業、以及人才、稅賦、資金、設備及內需市場上，大力支持其本土業者。而美國政府也通過晶片科技法案，大力扶植在地研發與製造。期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢在全球的優勢。

最後，理事長表示，面對現今半導體產業的挑戰與機會，在這關鍵時刻，期許持續為台灣半導體產業在瞬息萬變的國際環境中爭取競爭優勢，本會今年年會特別規劃AI主題，邀請到微軟公司(Microsoft)兩位重量級嘉賓Rani Borkar, Corporate Vice President, Azure Hardware Systems & Infrastructure，以及Eric Boyd, Corporate Vice President, AI Platform 擔任Keynote演講嘉賓並分享【Partnering in the Age of AI: The changing role of the semiconductor industry】專題，

微軟表示當今的AI時代，被譽為是自個人電腦和手機出現以來最重要的科技時刻。無論身處何處，人們都在積極討論著大型語言模型所帶來的優勢，而各行各業也都渴望能透過生成式AI改善客戶體驗並提高生產力。微軟更致力於以負責任且可靠的方式提供基礎設施和工具，來發揮AI巨大的潛能。

那麼，半導體產業在這次的科技風暴中又扮演了什麼樣的角色？從晶片到系統，再到服務，極有可能影響AI技術堆棧中的每一層。要在半導體構建模塊上發展AI，需要創造力、協作和創新，這更涵蓋了供應鏈營運、電源管理和電子設計自動化等多個面向。在這次演說中，我們將探討一種全新的合作模式，來應對超級運算革命的來臨。

同時論壇主題定為【Generative Artificial Intelligence and Semiconductor生成式人工智慧與半導體】，由常務理事聯發科技子公司聯發聯發創新基地總負責人許大山博士主持論壇，並邀請微軟台灣研發中心(Microsoft Taiwan)張仁炯總經理、輝達 (NVIDIA) Jerry Chen, Director of Global Business Development for Manufacturing & Industrials、聯發科技(MediaTek)周漁君執行副總經理暨技術長、台積電(TSMC)林宏達企業資訊技術副總經理暨資訊長、Google Taiwan馬大康董事總經理等多位產業知名專家和與會者互動，共同尋求台灣半導體產業永續成長之契機。

並於會中頒發2023 TSIA半導體獎：具博士學位之新進研究人員由國立台灣大學電子工程學研究所博後研究員吳易忠獲獎；博士研究生獎分別由5校11位同學獲獎，包括臺灣大學電子工程學研究所林鑫成同學、莊育權同學、鄭浩天同學；陽明交通大學電機工程學系王資文同學、陽明交通大學國際半導體產業學院梁晏煊同學、陽明交通大學電子研究所黃欣慧同學；清華大學電機工程學系洪哲民同學、清華大學工程與系統科學系彭皓楷同學；成功大學電機工程研究所李承穎同學、張書維同學；中山大學材料與光電科學所吳珮瑜同學，恭喜以上獲獎同學，未來持續為半導體產業發光發熱。

關於 TSIA：

台灣半導體產業協會成立於 1996 年，是一個以"關心產業發展"為出發點的民間團體，透過協會的活動凝聚業界對產業發展的共識，以促成競爭中的合作，提升整體產業競爭力並促進整體產業的健全發展。TSIA 現有研發、設計、製造、封裝、測試、設備、材料等會員廠商約 190 家，約佔台灣整體 IC 產業產值的百分之八十。更多資訊，請上網查詢。**活動報名及詳細** 連結網址: <https://www.tsia.org.tw/annual2023/>。

新聞聯絡人：

台灣半導體產業協會 吳素敏資深協理 Tel:+886-3-591-3477, Email:julie@tsia.org.tw